

EPMOLD MP50

轻质环氧糊状代木

产品描述

EPMOLD MP50 是环氧糊状代木，可用行星式混合机混合，再手工以 10-50 mm 厚度铺覆在粗成型基体上，在室温下固化。EPMOLD MP50 操作时间长、放热低，用于大型模型、工装模具和轻质检具制作。

主要特性

• 质量混合比 1:1 • 操作时间长，放热低 • 可手工或行星式混合机混合 • 轻质，易于铣削 • 施工厚度可达 50mm • 铣削后表面细腻

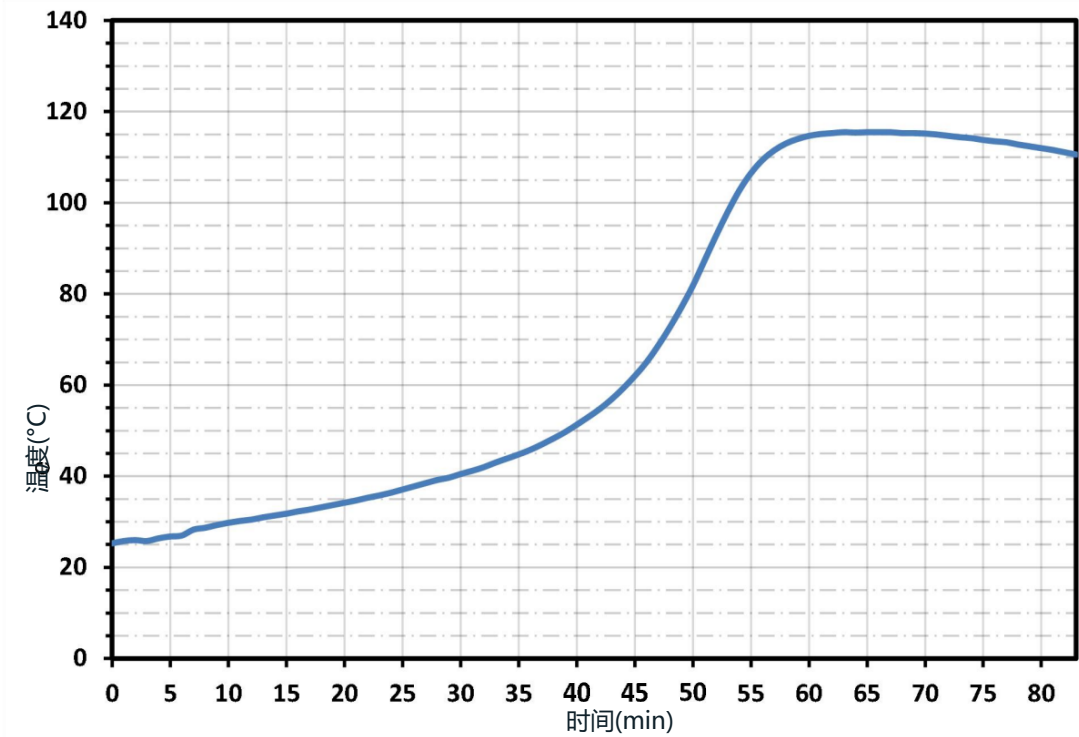
物理性能

	测试标准	树脂	固化剂
质量混合比		100	100
外观	目视	膏状	膏状
颜色	目视	白色	粉红色
25℃ 时的比重 (g/cm3)	ISO1675:1985	0.50-0.55	0.45-0.50
25℃ 时固化产物的比重	ISO2781:1996	0.45-0.50g/cm3	
25℃ 时的可操作时间(500)		40-70min	
25℃ 时可铣削加工的时间		16-20 小时	
保质期		12个月	

04/2026 EPMOLD MP50 环氧糊状代木 1 / 3

放热曲线

25 °C 下 MP50 的放热曲线(混合 500g)



温度(°C)

时间(min)

力学性能

	测试标准	EPMOLDMP50
硬度	ISO868:2003	邵D52-60
弯曲强度	ISO178:2001	10-20MPa
压缩强度	ISO604:2002	15-25MPa
Tg(25°C 固化 7 天)	ISO11357:2002 (DSC)	> 50°C
Tg(25°C 24h+40°C 16h)	ISO11357:2002 (DSC)	> 60°C
热膨胀系数(CTE)	ISO11359:1999	约45*10-6K-1
最大铺覆厚度		50mm

(1) 标准试样测得的平均值 / 固化条件:40°C 16 小时

04/2026 EPMOLD MP50 环氧糊状代木 2 / 3

操作指南

按规定比例手工或用行星式混合机混合两组分，混合均匀后压覆到粗成型基体上。为改善与支撑体的粘接，建议先手工或用工具薄涂一层。室温固化 16 至 20 小时后再进行机加工。

包装规格

EPMOLDMP50 树脂	EPMOLDMP50 固化剂
1×8.0kg	1×8.0kg

储存条件

两组分在 15 至 25°C 的干燥环境中以原包装未开封储存，保质期均为 12 个月。低温储存会变硬、难以混合，建议加热至 40-60 °C，直至软化到易于混合的程度。加温不会影响最终产品性能。开封容器使用后必须立即严密封闭。

安全注意事项

操作本产品时应遵守常规健康与安全措施:确保通风良好，佩戴手套和护目镜。详情请参阅产品安全数据表。

质量保证说明--请仔细阅读

本文件的信息以诚信提供，并相信其准确。但产品的使用条件和方法超出本公司的控制范围，因此这些信息不能代替客户自行试验，以确认产品对预期用途的安全性、有效性和适用性。

04/2026 EPMOLD MP50 环氧糊状代木 3 / 3